



環球晶圓(6488 TT) 2020年第1季營運報告

2020年5月



Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.



環球晶圓概覽



環球晶圓概覽

- 2011年自中美矽晶 (5483 TT) 分割,環球晶圓迅速成長為**世界第三大**的專業半導體晶圓製造商。
- 我們的營運據點遍佈亞洲、歐洲與美洲，擁有**無可匹敵**的生產彈性與產品研發能力。
- 產品光譜涵蓋 **3吋到 12吋**，可以滿足客戶各式各樣的產品需求。



環球晶圓概覽

- 世界領先的半導體晶圓製造商。
- 卓越的經營模式與市場優勢奠定了環球晶圓在半導體產業的重要地位。

重要經營成果



Note:

1. 包括已獲證&申請中之專利
2. 現金 = 現金&約當現金 + 受限制現金



Global Family, Global Solution

- Our vision is to be the preferred partner in customers' technology journey.
- We are one global family committed to providing sustainable solutions for the semiconductor industry.



全球佈局&穩定供應

- ✓ 遍佈世界各國的工廠能多元供應
- ✓ 本地供應減少總體經濟的不確定性與地緣政治摩擦
- ✓ 靈活調配全球產能，可彈性出貨

完整產品光譜

- ✓ 3吋~ 12吋
- ✓ CZ & FZ
- ✓ 磊晶片、拋光片、擴散片、SOI、粗晶片

全球銷售管道 & 具競爭力的成本優勢

- ✓ 產能優化降低生產成本
- ✓ 營運達經濟規模，具成本效益



實力堅強

82%

營收
CAGR

61%

每股盈餘
CAGR

穩健快速成長

自2011年起，營收年複合成長率達82%，每股盈餘年複合成長率達61%

35bn

現金*

現金充裕

現金* 達股東權益
97%

>25%

高股東權益 報酬率

自2018年起，
股東權益報酬率持
續超越25%

8%

折舊/營收 %

低折舊費用

透過併購獲得的固
定資產降低了折舊
費用，更有效率地
轉化為獲利

Note：現金 = 現金&約當現金 + 受限制現金

穩定配發現金股利、股東報酬最大化



信守與股東分享成長果實的承諾，連續8年股利配發率高於80%



2019 每股股利NT\$25，總配發金額達NT\$ 108億^{*1}.



每半年派發股息^{*2}，為股東帶來穩定現金收入。

Note :

1. 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。

2. 待2020年6月23日股東會常會決議。

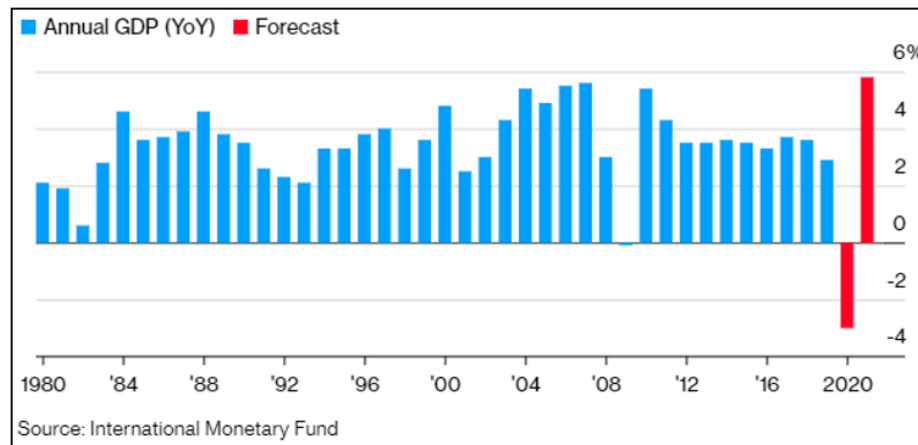
2020上半年股利 → 2021第1季配發 / 2020下半年股利 → 2021第3季配發



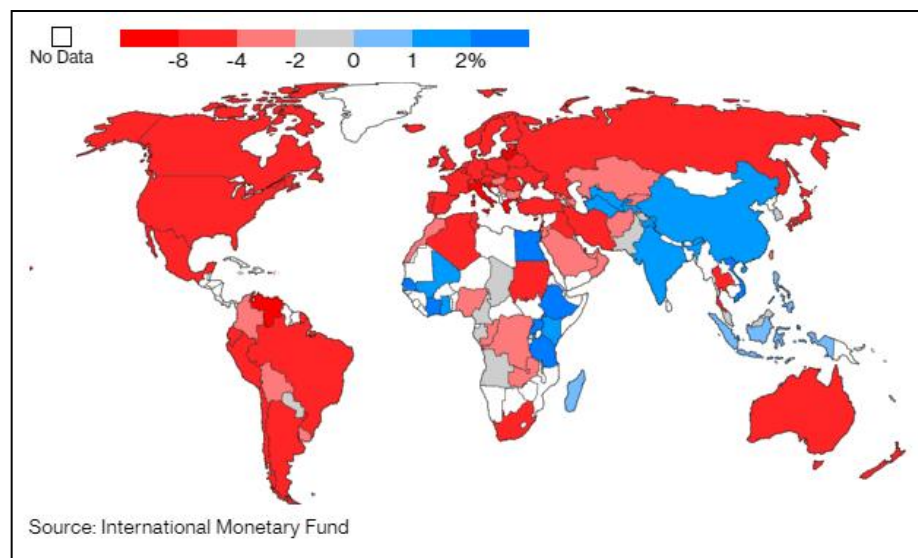
新冠肺炎的影響

全球經濟展望

- IMF下修全球經濟展望，預估「全球大封鎖」(Great Lockdown)是這世紀以來以來最嚴重的經濟衰退，如果新冠肺炎持續或再度爆發，全球經濟的復甦可能比預期更緩慢。



- IMF下調2020年全球經濟展望，由1月預估的3.3%調降約6%至-3%，此波疫情影響甚於2009年，當時金融危機全球經濟萎縮0.1%。



國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟展望



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

➤ 需要堅實的資產負債表來因應新冠肺炎後的資本支出

(real GDP, annual percent change)	2019	2020	2021
World Output	2.9	-3.0	5.8
Advanced Economies	1.7	-6.1	4.5
United States	2.3	-5.9	4.7
Euro Area	1.2	-7.5	4.7
Germany	0.6	-7.0	5.2
France	1.3	-7.2	4.5
Italy	0.3	-9.1	4.8
Spain	2.0	-8.0	4.3
Japan	0.7	-5.2	3.0
United Kingdom	1.4	-6.5	4.0
Canada	1.6	-6.2	4.2
Other Advanced Economies	1.7	-4.6	4.5
Emerging Markets and Developing Economies	3.7	-1.0	6.6
Emerging and Developing Asia	5.5	1.0	8.5
China	6.1	1.2	9.2
India	4.2	1.9	7.4
ASEAN-5	4.8	-0.6	7.8
Emerging and Developing Europe	2.1	-5.2	4.2
Russia	1.3	-5.5	3.5
Latin America and the Caribbean	0.1	-5.2	3.4
Brazil	1.1	-5.3	2.9
Mexico	-0.1	-6.6	3.0
Middle East and Central Asia	1.2	-2.8	4.0
Saudi Arabia	0.3	-2.3	2.9
Sub-Saharan Africa	3.1	-1.6	4.1
Nigeria	2.2	-3.4	2.4
South Africa	0.2	-5.8	4.0
Low-Income Developing Countries	5.1	0.4	5.6

Source: IMF, World Economic Outlook, April 2020

IDC對新冠肺炎疫情的復甦預估

- 無論是以下何種情境，最終勝出者必須能積極掌握如5G、物聯網、高效運算與智慧終端等創新科技所伴隨的需求。
- 我們擁有度過目前環境逆風的所需資源，也已經準備好滿足顧客的各式需求。

新冠肺炎疫情的復甦情境模擬

2020 Worldwide Semiconductor Revenue Growth Forecast Scenarios	Technology Supply Chain Recovery	Global Disruption to Economy and Technology Demand	Impact on Broader Technology Industry & Initiatives
Scenario 1: Decline -12% or more	1-3 months	9-12+ months	9-12+ months
Scenario 2: Decline -3 to -6%	3-9 months	3-9 months	3-9 months
Scenario 3: Growth +2%	1-3 months	3-9 months	3-9 months
Scenario 4: Growth +6% or more	1-3 months	1-3 months	1-3 months
Source: IDC, March 2020			

半導體在新冠肺炎疫情中扮演的關鍵角色

- 半導體在各種層面的經濟活動中是不可或缺的元件，使基礎設施和社會得以持續運行。
- 除了消費性產品，半導體也廣泛使用於各項關鍵設施，例如電信通訊、能源、金融、交通運輸與醫療設備。
- 居家隔離或封鎖政策將會擴大對數位服務的需求。
- 世界各國重要經濟體將半導體產業視為“維持營運的不可或缺產業（essential business）”。



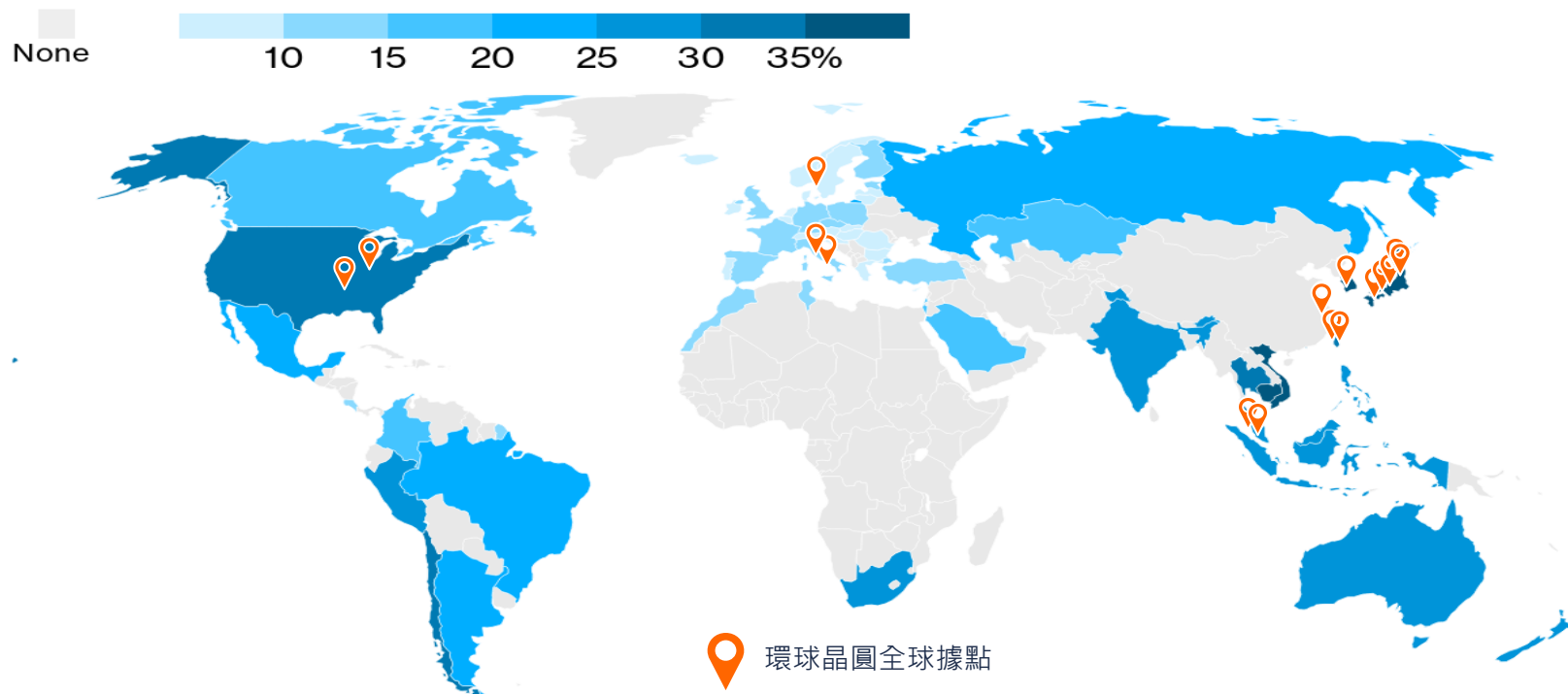
環球晶圓關於新冠肺炎的對策

- 為關鍵原料建立安全庫存，降低供應鏈中斷風險。
- 因應各國隔離措施，利用全球據點彈性調度生產。
- 建立多層供應鏈、妥善管理風險，降低對單一區域的依賴。
- 持續評估財務狀況與市場狀態，並採取相應措施。
- 關注所處的競爭環境與供應鏈變遷，迅速適應新模式。

新冠肺炎帶來的考驗

- 新冠肺炎使得眾多公司開始反思自身的全球供應鏈政策。
- 重新形塑全球供應鏈
- 當此情況發生時，佈局全球據點廣泛的環球晶圓擁有最佳優勢。

從中國輸入製造業中間產品的比例



Source: OECD TiVA, Bloomberg Economic, February, 2020

對於新冠肺炎供應鏈的潛在反應

1. 去全球化

- 企業可能會試著避免未來供應鏈的中斷風險
- 將加速消滅全球經濟體間的互相依賴與整合

我方看法：

環球晶圓兼具**全球供應與在地供應**之優勢

環球晶圓的世界據點是降低全球環境不確定性的最佳風險管理計畫

- 遍佈世界各國的工廠能多元供應
- 本地供應減少總體經濟的不確定性與地緣政治摩擦
- 靈活調配全球產能，可彈性出貨



對於新冠肺炎供應鏈的潛在反應

2. 中國強化本地供應鏈

- 當企業試著採取多元化政策並降低對中國的依賴時，將使中國加速建立自給自足的半導體供應鏈。

我方看法：

- 建立供應鏈需要時間
- 存在技術差距
- 客戶對專利的顧慮以及與現有夥伴的合作關係對新加入的競爭者而言將是重大障礙

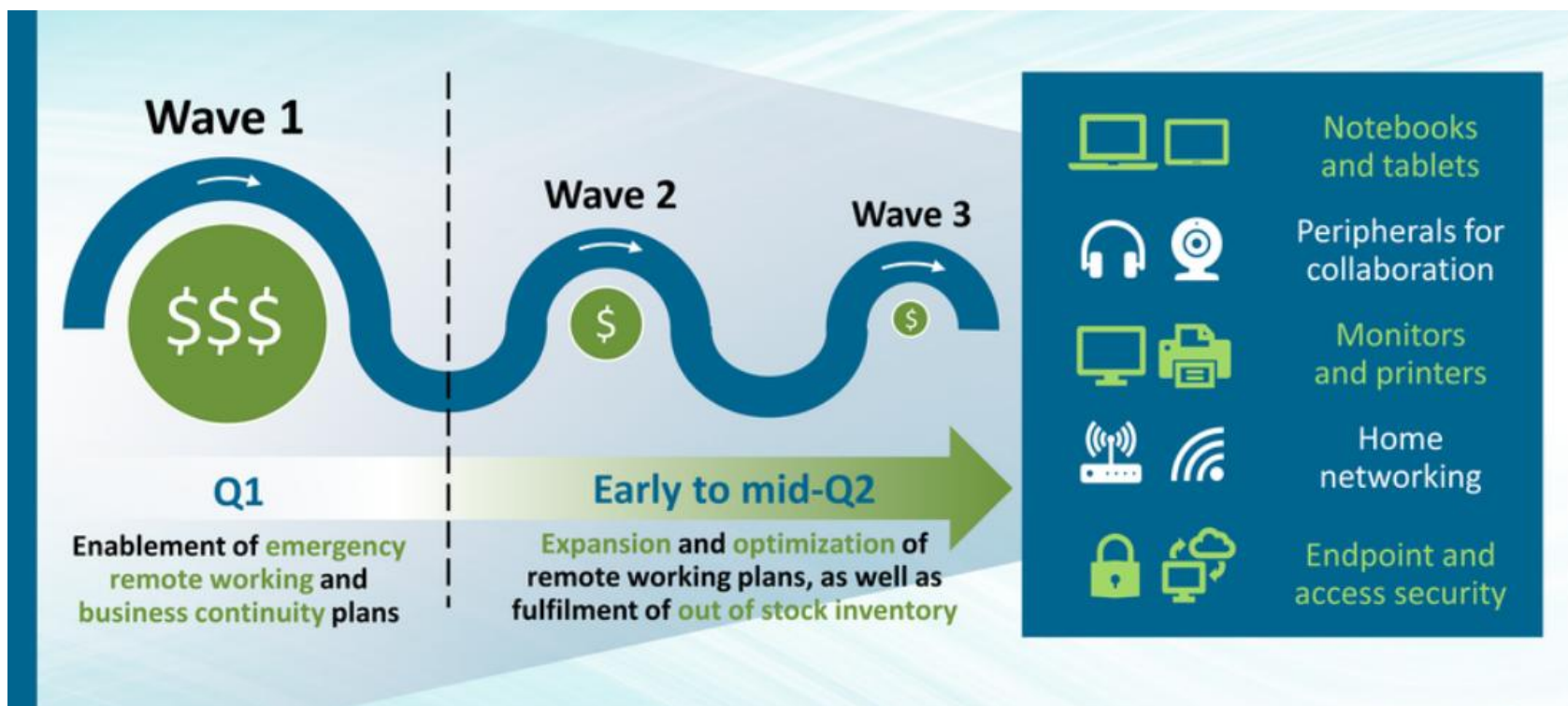


產業概況

2020年第1季蓬勃發展的科技產品

- 當工作模式突然切換為遠距，WFH(Work From Home) & ROHO (Remote Office Home Office)將帶動相關需求成長。

2020年第1季蓬勃發展的科技產品



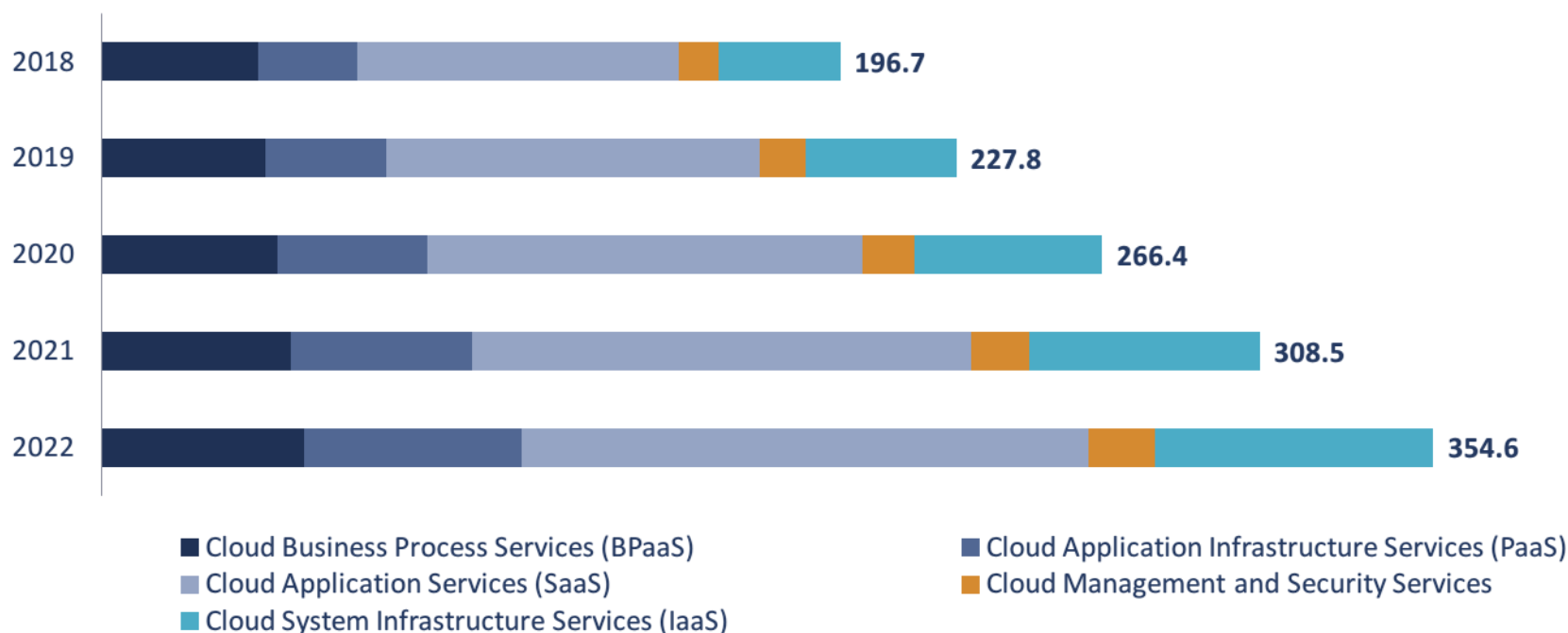
Source: Canalyses, April, 2020

全球公共雲端服務市場

- 研調機構預測，2020年全球公共雲端服務市場規模將達到2,664億美元，相較2019年的2,278億美元成長17%。

全球公共雲端服務市場預估

(USD bn)

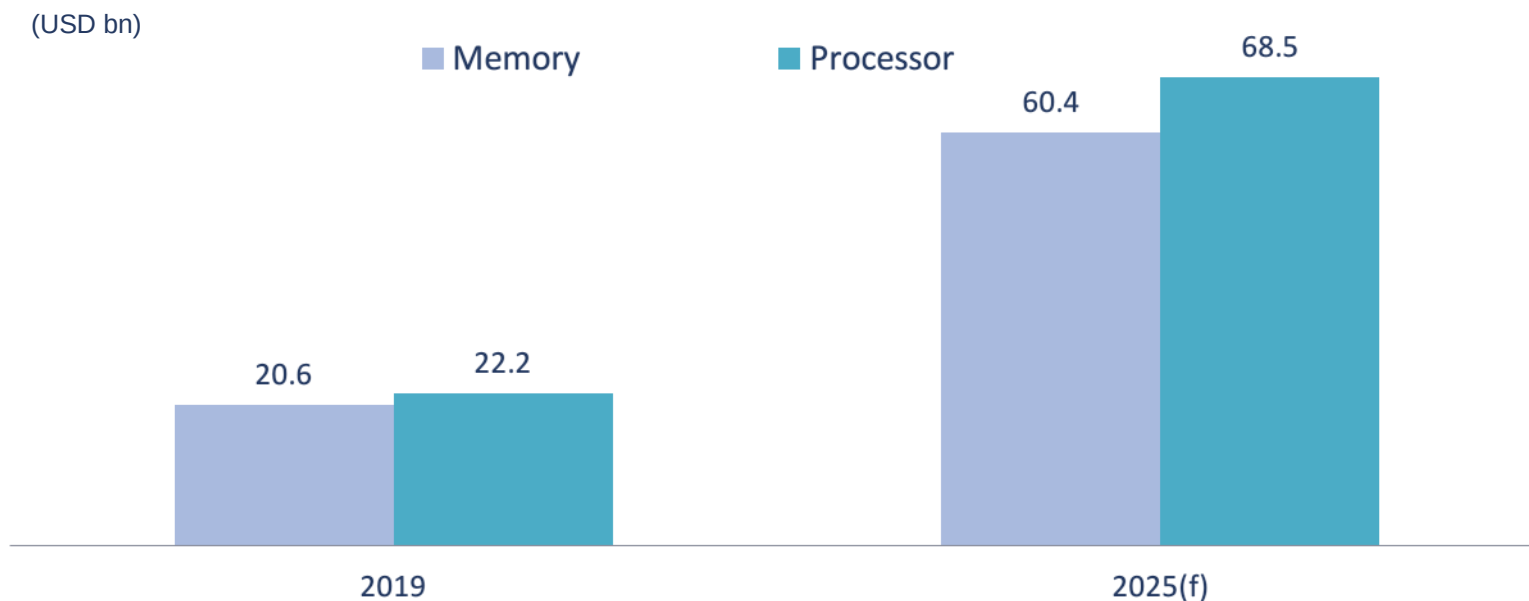


Source: Gartner, April, 2020

AI功能晶片持續成長

- 因AI功能晶片可利用於多種創新科技，預估將在接下來的5年蓬勃發展。
- 高度運算功能與深度學習能力可以廣泛應用於各種層面。
- AI 和大數據結合有助於遏止新冠肺炎疫情擴散。

具AI功能的半導體市場預估 (2019 - 2025)

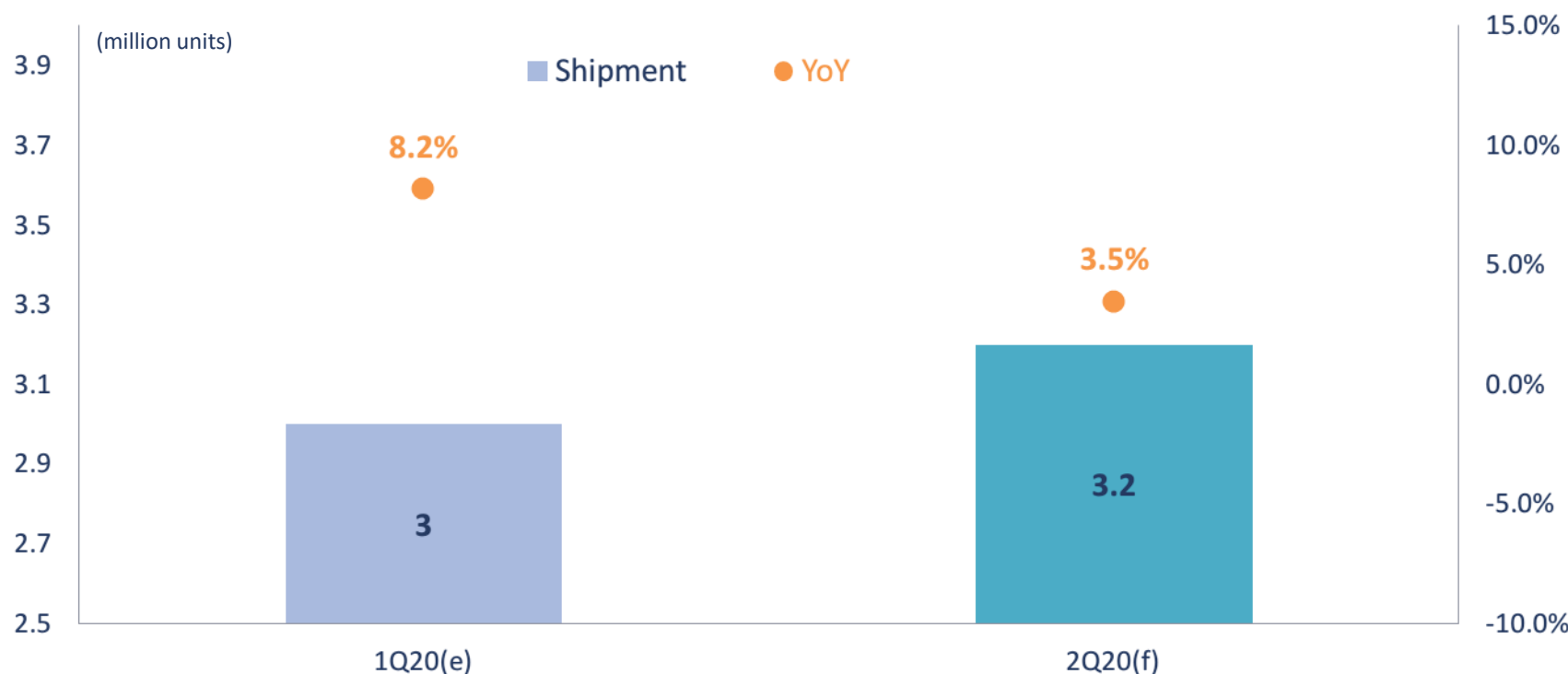


Source: IHS Markit, January, 2020

伺服器出貨強勁

- 受惠於資料中心訂單持續暢旺，加上傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響斷料而提前備貨，第二季伺服器出貨持續成長。

全球伺服器出貨量預估



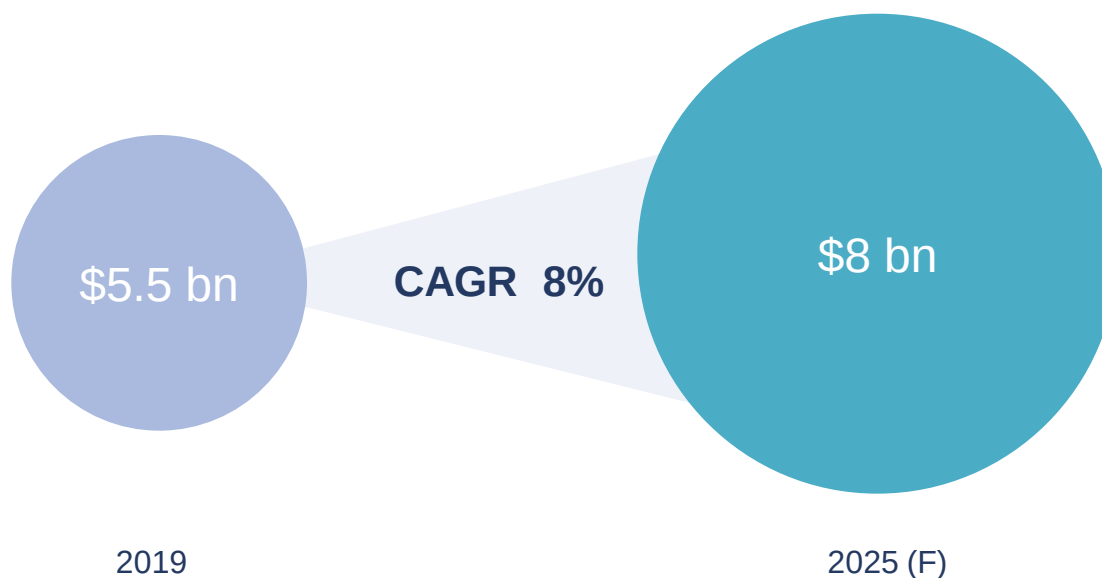
Source: TrendForce, April, 2020

醫療電子市場預測

- 應用於醫療電子的半導體市場產值預計每年以8%的年複合成長率成長，從55億美元開始，至2024年將達近8億美元。
- 在工業用半導體中醫療電子半導體是成長最快的市場。類比、數位與感測器需求將驅動強勁成長。

醫療電子半導體市場預測

(USD bn)



Source: Business Wire, November end, 2019

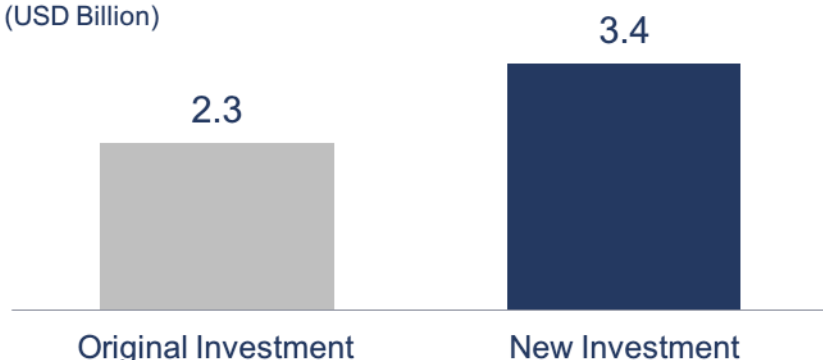
5G基礎建設加速發展

➤ 雖然全球經濟仍籠罩著新冠肺炎陰影，許多國家視5G為刺激經濟發展的關鍵並加速發展。

韓國

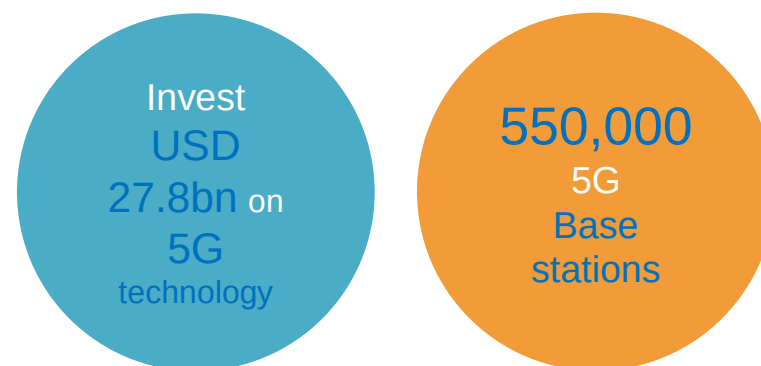
3大電信將5G網路的投資金額由原先的23億美元拉高至34億美元

(USD Billion)



中國

中國發展“新基礎建設”專案加速佈建5G架構與資料中心，許多電信商加重投資力道。



日本

✓ SoftBank, NTT DoCoMo 與KDDI 的5G服務比原訂時程提早4個月。

✓ Rakuten Mobile 將在6月提供5G服務

美國

- 無線通信產業計劃在5G網絡上投資**2750億美元**
- 史上最大規模的頻譜拍賣



2020年第1季營運表現

經營團隊重點報告

➤ 前景展望

- 總體經濟、半導體/晶圓產業充滿變化。市場預估將與新冠肺炎的蔓延程度與時間高度連動，是現階段的“最佳猜測”。
- 半導體產業被全球許多大經濟體視為不可或缺(“Essential”)的產業，環球晶圓全球各營運據點皆正常運作。
- 醫療電子與遠距工作帶動相關需求。
- 客戶建立安全庫存以避免供應鏈中斷，
- 近期的需求概況不甚明朗，但長期的產業潮流仍將正向發長，因5G, 邊緣運算、AIoT, 工業4.0 等將刺激需求、帶動發展。
- 2020年下半年展望將視新冠肺炎疫情蔓延程度而定，若疫情能有效阻遏則回復供需平衡。
- 復甦時機的主要關鍵因素:
 - 全球總體經濟復甦時機
 - 有效控制新冠肺炎疫情的時機
 - 資料儲存產業復甦並驅動記憶體資本支出時機
 - 智慧型手機市場的時機
 - 汽車市場的復甦時機
- 各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊而提出的紓困方案可能會刺激新一波需求。



➤ 2020年第1季

- 2020年第1季底晶圓出貨上揚，但新冠肺炎疫情蔓延、各國實施的封境政策帶來運輸成本上升，侵蝕部分獲利
- 2020年第2季晶圓出貨量預估將持平或與第1季非常接近。第2季的晶圓需求將視以下因素而定：新冠肺炎疫情是否能有效控制或持續蔓延、各國紓困措施的實施與有效程度。
- 營運活動產生的現金流 NTD 3,168mn (US\$ 105mn)* 與現金部位 NT\$ 35,547mn (US\$ 1,176mn)* 反映了環球晶圓的正確營運策略，也顯示了我們經營模式和財務的優勢

Note:

1. FX Rate: NTD:USD = 30.225

2. 現金 = 現金&約當現金 + 受限制現金



2020年第1季財務摘要

➤ 營運穩健

● 營收

- ✓ NTD 13,515mn (QoQ : 0.1%)
- ✓ EBITDA: 5,015mn (QoQ : 1.1%)
- ✓ EBIT: 3,845mn (QoQ : 1.9%)

● 運輸成本上升微幅侵蝕獲利

- ✓ GM: 36.5% (QoQ : -1.7%)
- ✓ Operating Profit: 28.2% (QoQ : -0.3%)
- ✓ Net Profit : 21.3% (QoQ : -0.2%)
- ✓ EPS: NTD 6.62 (QoQ : - NTD 0.06)

➤ 財務比例

- 充足現金* – NT\$ 35,547mn (US\$ 1,176mn)*.
- 預付貨款 – NT\$ 19,441mn (US\$ 643.2mn)*

Note:

1. FX Rate: NTD:USD = 30.225

2. 現金 = 現金&約當現金 + 受限制現金



財務摘要: 2020年第1季 vs. 2019年第4季

(NT\$百萬)	1Q20	4Q19	季成長率
營業收入	13,515	13,506	0.1%
EBITDA* ¹	5,015	4,959	1.1%
EBITDA (%)	37.1%	36.7%	1.1%
EBIT	3,845	3,772	1.9%
營業淨利	3,805	3,853	-1.3%
營業淨利(%)	28.2%	28.5%	-0.4%
本期淨利	2,880	2,908	-1.0%
本期淨利 (%)	21.3%	21.5%	-0.2%
每股盈餘	NT\$6.62	NT\$6.68	-NT\$0.06
股東權益報酬率 / ROE* ² (年化)	28.2%	30.9%	-2.7%
資產報酬率 / ROA* ³ (年化)	12.0%	14.7%	-2.7%

1. EBITDA = 本期淨利 + 折舊費用 + 攤銷費用 + 利息 + 所得稅

2. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益

3. ROA = ((本期淨利 + 利息 * (1 - 有效稅率)) / 平均資產

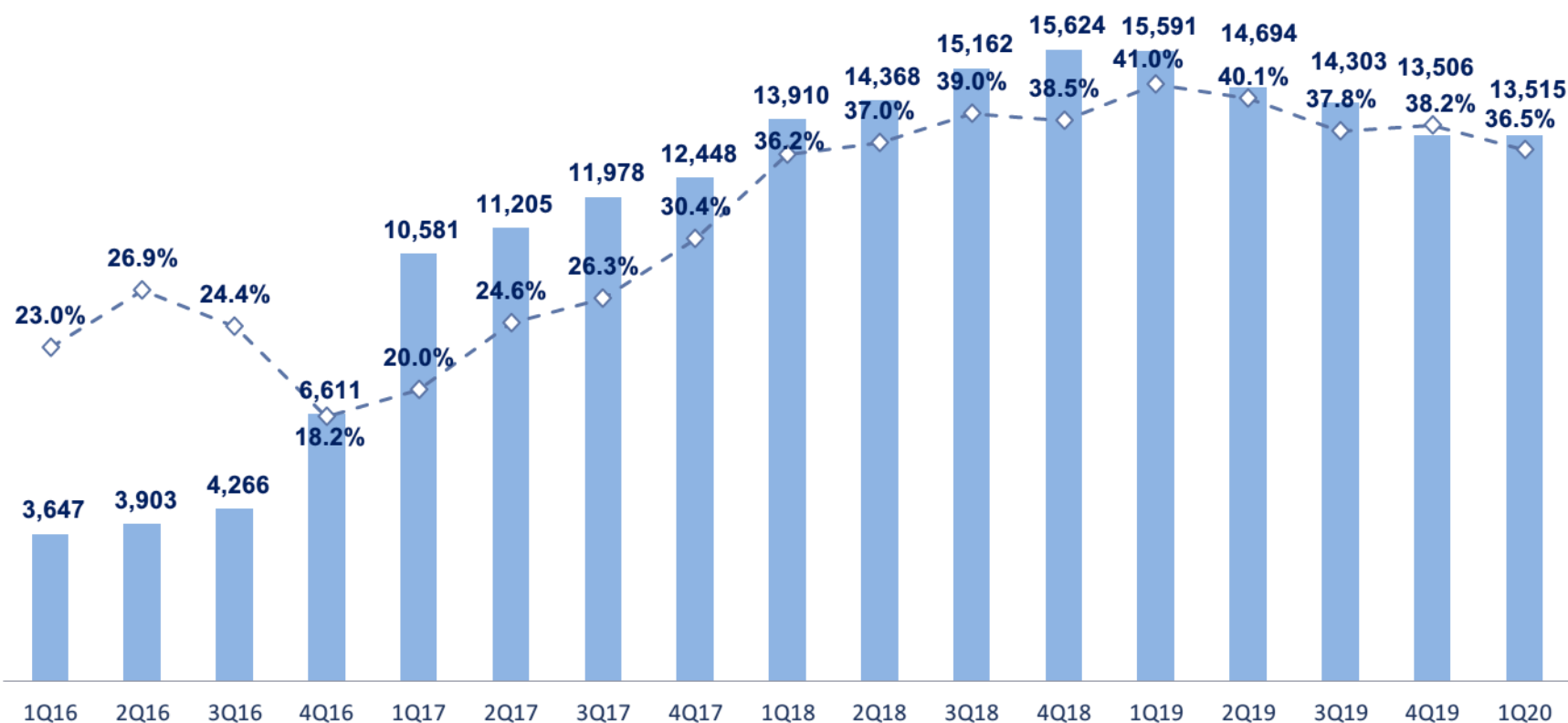


營業收入 & 毛利

營業收入 & 毛利

(NT\$mn)

Revenue —◇— GM %

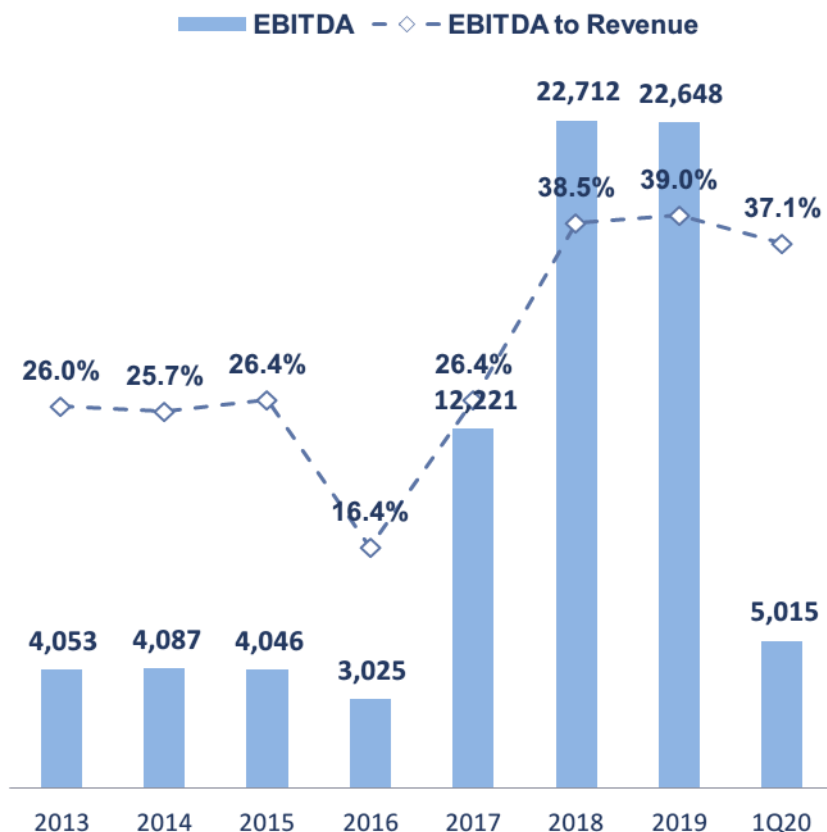




EBITDA & 每股盈餘

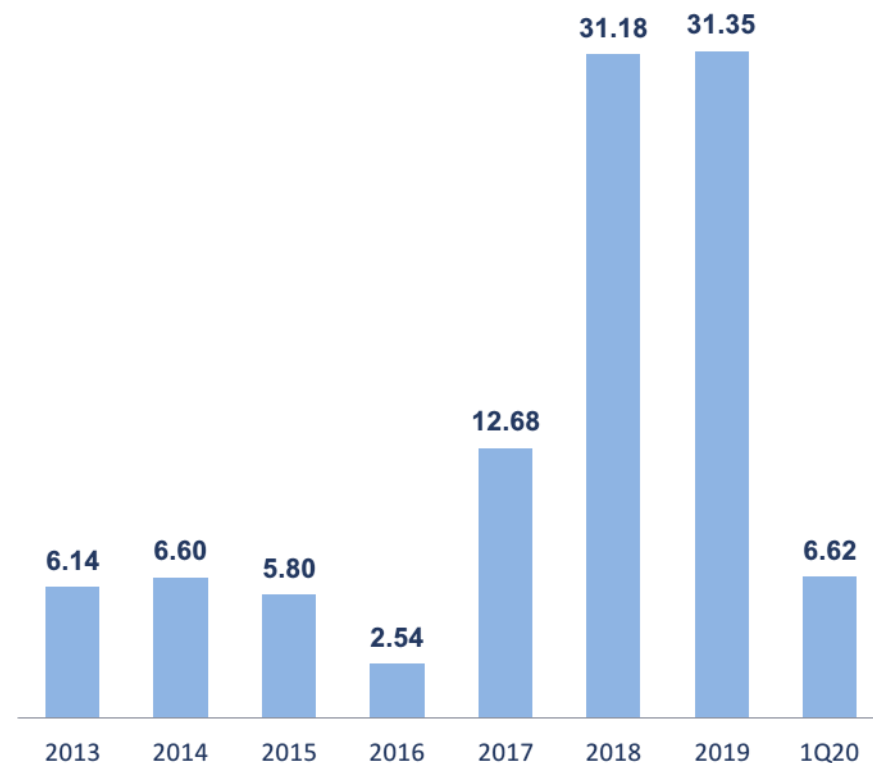
EBITDA

(NT\$mn)



EPS

(NT\$)

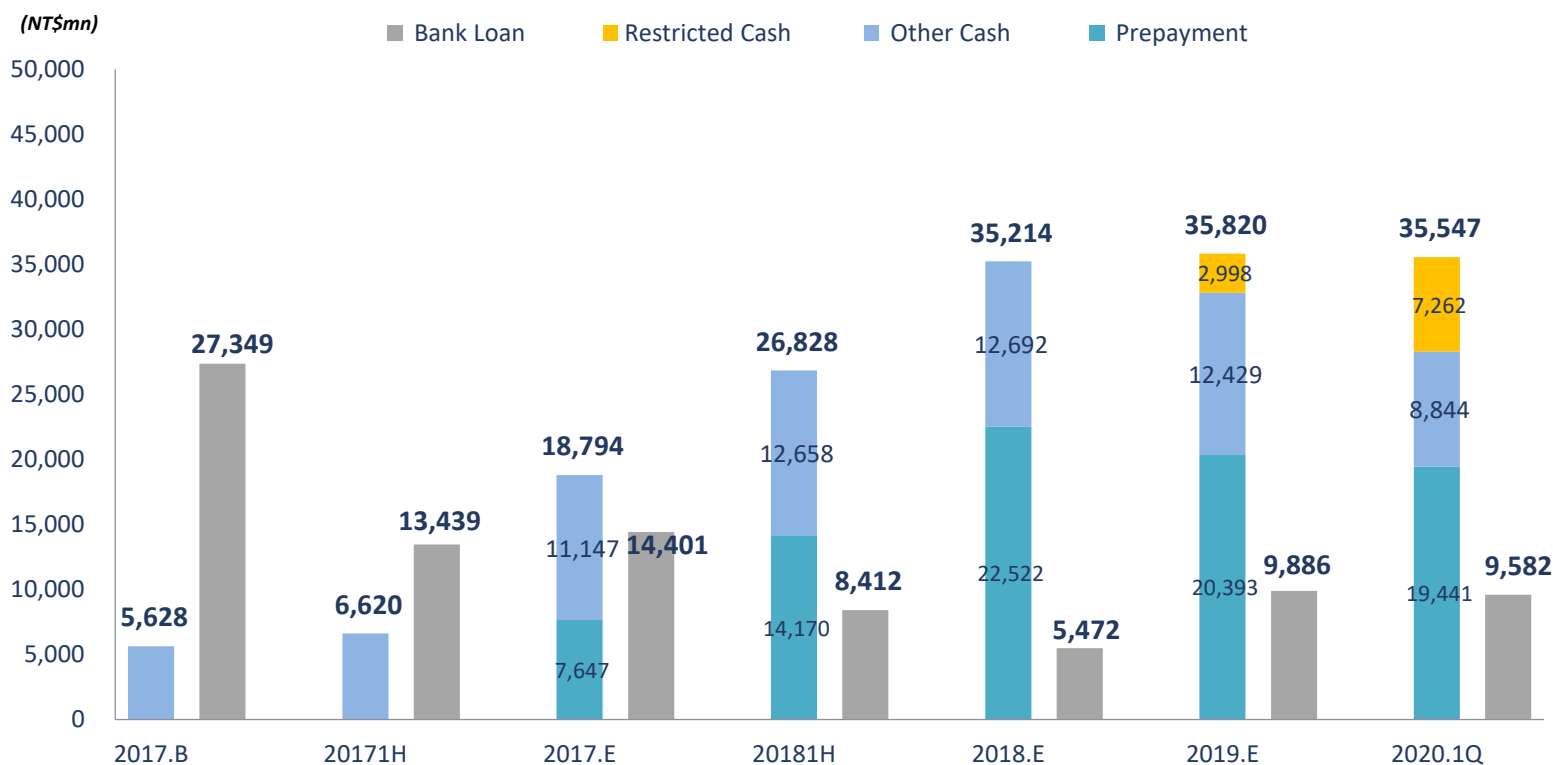




財務比率

- 環球晶圓的充足現金可支撐永續發展
- 股利配發拉高銀行貸款。

Cash Structure and Bank Loan



Note: 現金 = 現金&約當現金 + 受限制現金



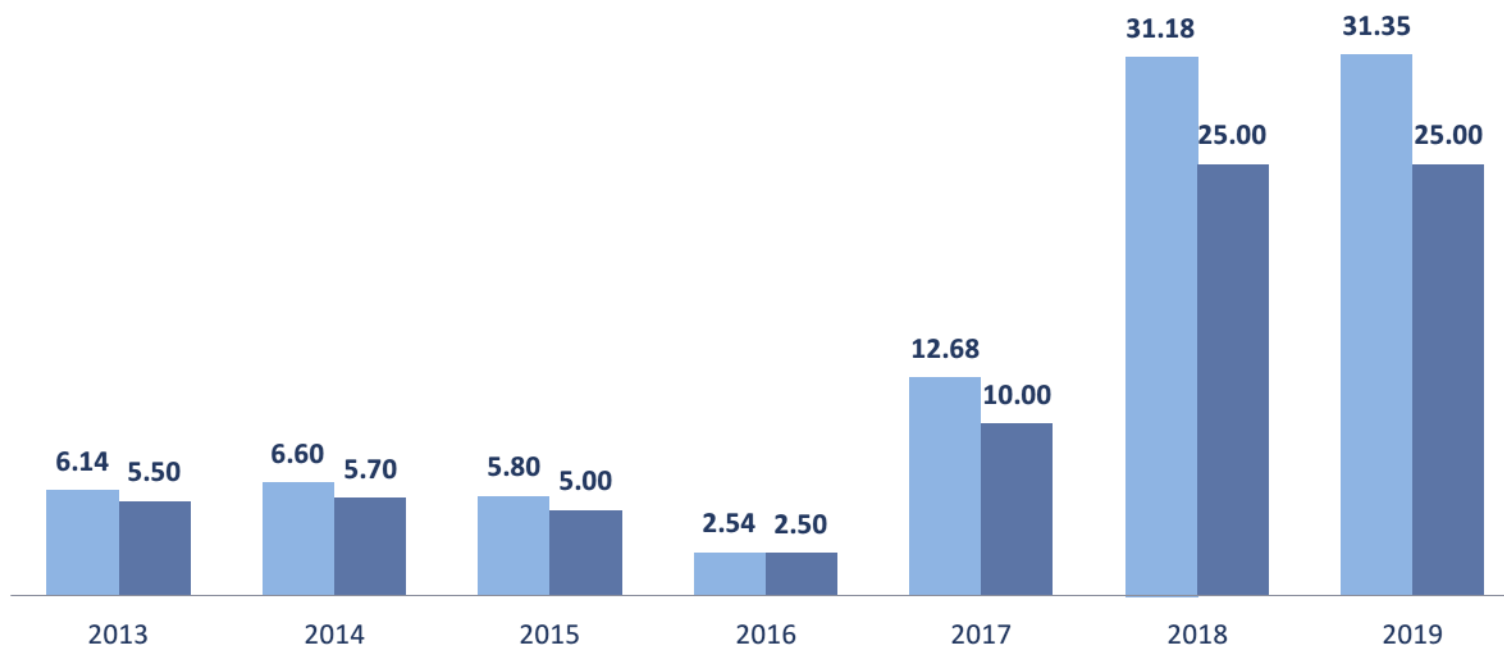
股利配發

➤ 每股盈餘創歷史新高，帶來豐厚股利

每股股利配發與EPS

(NT\$)

■ EPS ■ Dividend



股利
配發率

89.6%

86.4%

86.2%

98.4%

78.9%

80.2%

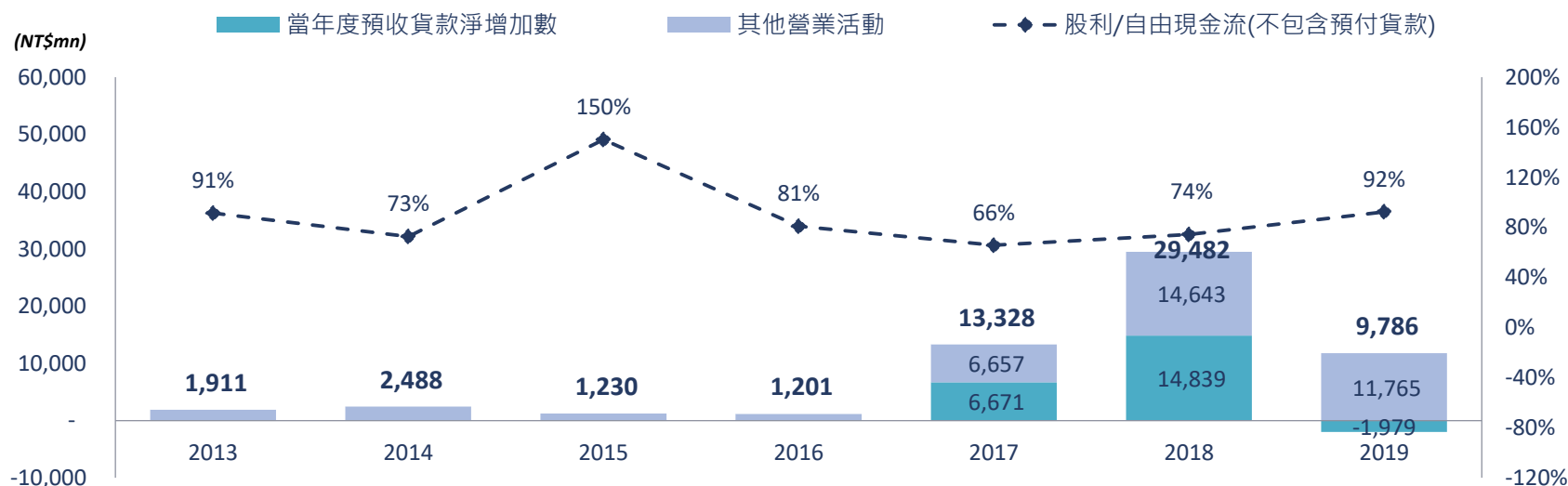
79.7%

* 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。

多次股利分配

- 每半年派發股息將有助於股東的資金活用與投資活動，協助股東創造更大的投資價值。
- 穩健的股利配發政策顯示環球晶圓信守經營成果回饋予股東的承諾，可望為股東帶來實質的投資效益。
- 股利配發時程：
 - 2020上半年股利 → 2021第1季配發
 - 2020下半年股利 → 2021第3季配發

股利配發 vs. 自由現金流*



備註:

- * 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。
- 自由現金流量=營業活動淨現金流入-資本支出
- 2019預付貨款較低主因為2019年部分長約已出貨。



綜合損益表

綜合損益表

(NT\$百萬)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1Q20
營業收入	15,570	15,922	15,310	18,427	46,213	59,064	58,094	13,515
成長率(%)	-	2.3%	-3.8%	20.4%	150.8%	27.8%	-1.6%	-
營業毛利	3,663	3,728	4,073	4,130	11,808	22,299	22,847	4,938
營業毛利率(%)	23.5%	23.4%	26.6%	22.4%	25.6%	37.8%	39.3%	36.5%
EBITDA	4,053	4,087	4,046	3,025	12,221	22,712	22,648	5,015
EBITDA 率(%)	26.0%	25.7%	26.4%	16.4%	26.4%	38.5%	39.0%	37.1%
營業淨利	2,194	2,336	2,685	1,378	7,414	17,578	17,897	3,805
營業淨利率(%)	14.1%	14.7%	17.5%	7.5%	16.0%	29.8%	30.8%	28.2%
稅前淨利	2,204	2,679	2,808	1,344	6,875	18,253	18,554	3,922
稅前淨利率(%)	14.2%	16.8%	18.3%	7.3%	14.9%	30.9%	31.9%	29.0%
淨利	1,948	2,095	2,044	939	5,278	13,634	13,636	2,880
淨利率(%)	12.5%	13.2%	13.4%	5.1%	11.4%	23.1%	23.5%	21.3%
EPS (NT\$)	6.14	6.60	5.80	2.54	12.68	31.18	31.35	6.62

Note: 2016年GWC完成SunEdison半導體(SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。



資產負債表

資產負債表

(NT\$百萬)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1Q20
資產								
現金及約當現金	1,536	2,685	3,662	5,628	18,794	35,214	32,822	28,285
應收帳款	3,165	3,694	4,538	7,642	7,869	9,226	8,140	8,574
存貨	3,291	2,829	3,262	7,307	7,347	7,040	6,849	6,416
不動產、廠房及設備	9,796	8,972	9,361	31,036	28,202	30,887	34,697	35,747
其他資產	3,286	3,204	2,994	8,948	8,020	7,455	14,078	17,691
資產總計	21,074	21,385	23,816	60,560	70,232	89,822	96,586	96,713
負債								
短期借款	1,302	2,069	696	12,982	10,738	5,042	9,886	9,582
應付帳款	1,816	1,789	1,383	5,126	4,269	4,870	3,837	3,746
長期借款	--	--	--	14,367	3,663	430	0	0
其他負債	4,821	4,325	5,012	12,267	17,508	36,324	37,790	46,812
負債總計	7,939	8,184	7,091	44,742	36,178	46,666	51,513	60,140
權益總計	13,135	13,201	16,725	15,819	34,054	43,156	45,073	36,573

Note:

1.2016年GWC完成SunEdison Semiconductor (SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。

2.應收帳款包括關係人。

3.應付帳款包含關係人。



Q&A



Thank You
